

研究評価委員会
第1回「次世代半導体微細加工・評価基盤技術の開発」
(中間評価) 分科会

日 時： 平成 25 年 08 月 27 日 (火) 10:00~17:50

場 所： 大手町サンスカイルーム(朝日生命大手町ビル27階) D室

議事次第

【公開セッション】

- | | | |
|---|-----------------|-------------|
| 1. 開会、分科会の設置、資料の確認 | (説明 10 分) | 10:00~10:10 |
| 2. 分科会の公開について | (説明 5 分) | 10:10~10:15 |
| 3. 評価の実施方法と評価報告書の構成について | (説明 15 分) | 10:15~10:30 |
| 4. プロジェクトの概要説明 | | |
| 4.1 「事業の位置付け・必要性」及び「研究開発マネジメント」について
(NEDO 推進部) | (説明 15 分) | 10:30~10:45 |
| 4.2 「研究開発成果」及び「実用化・事業化に向けての見通し及び取り組み」について
(プロジェクトリーダー) | (説明 15 分) | 10:45~11:00 |
| 4.3 質疑応答 | (質疑 30 分) | 11:00~11:30 |
| ■ 非公開資料取り扱いの説明 | (説明 5 分) | 11:30~11:35 |
| —— (一般傍聴者退室) —— | —— (昼食 60 分) —— | 11:35~12:35 |

【非公開セッション】

- | | | |
|------------------------------|-----------|-------------|
| 5. プロジェクトの詳細説明 | | |
| 5.1 EUV マスクブランク欠陥検査技術開発 | (説明 15 分) | 12:35~12:50 |
| | (質疑 15 分) | 12:50~13:05 |
| 5.2 EUV マスクパターン欠陥検査技術開発 | (説明 15 分) | 13:05~13:20 |
| | (質疑 15 分) | 13:20~13:35 |
| 5.3 EUV レジスト材料技術開発 | (説明 20 分) | 13:35~13:55 |
| | (質疑 20 分) | 13:55~14:15 |
| —— (休憩 発表者・出席者を入れ替え 15 分) —— | | 14:15~14:30 |

6. 実用化・事業化に向けての見通し及び取り組みについて (発表項目毎、発表者・出席者を入れ替え)		
6.1 プロジェクト成果の活用の概要説明	(説明 5 分)	14:30~14:35
	(入替 5 分)	14:35~14:40
6.2 EUV マスクブランク欠陥検査装置事業化計画	(説明 10 分)	14:40~14:50
	(質疑 10 分)	14:50~15:00
	(入替 5 分)	15:00~15:05
6.3 EUV マスクパターン欠陥検査装置事業計画	(説明 10 分)	15:05~15:15
	(質疑 10 分)	15:15~15:25
	(入替 5 分)	15:25~15:30
6.4 EUV マスク事業計画	(説明 10 分)	15:30~15:40
	(質疑 10 分)	15:40~15:50
	(入替 5 分)	15:50~15:55
6.5 EUV レジスト事業計画	(説明 10 分)	15:55~16:05
	(質疑 10 分)	16:05~16:15
	(入替 5 分)	16:15~16:20
6.6 メモリ事業への EUVL 技術適用計画	(説明 10 分)	16:20~16:30
	(質疑 10 分)	16:30~16:40
—— (EIDEC のみ入室 10 分) ——		16:40~16:50
7. 全体を通しての質疑	(質疑 10 分)	16:50~17:00
—— (実施者・一般傍聴者入室 10 分) ——		17:00~17:10
【公開セッション】		
8. まとめ・講評	(講評 30 分)	17:10~17:40
9. 今後の予定、その他	(説明 10 分)	17:40~17:50
10. 閉会		

以上